

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】平成29年9月7日(2017.9.7)

【公開番号】特開2017-35355(P2017-35355A)

【公開日】平成29年2月16日(2017.2.16)

【年通号数】公開・登録公報2017-007

【出願番号】特願2015-159237(P2015-159237)

【国際特許分類】

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

【F I】

A 6 3 F 7/02 3 0 4 D

A 6 3 F 7/02 3 1 5 A

【手続補正書】

【提出日】平成29年7月31日(2017.7.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電極部を有しておりパッケージされた実装用電子部品を複数用いて遊技にかかる制御が実行されうる特定制御部を備え、遊技に応じた演出表示にて特別の表示態様が現れた場合、特典の付与が行われうる遊技機であって、
前記複数の実装用電子部品には、ディスクリット部品と集積回路部品とが含まれており、
前記特定制御部には、パターン配線が形成された基板内に実装用電子部品に設けられた電極部が挿入されるかたちで半田付けにより実装された挿入実装領域と、パターン配線が形成された基板の表面上に実装用電子部品に設けられた電極部が置かれるかたちで半田付けにより実装された表面実装領域とが設けられており、
前記特定制御部には、パターン配線が形成された基板内に実装用電子部品に設けられた電極部が挿入されるかたちで半田付けにより実装された挿入実装領域と、パターン配線が形成された基板の表面上に実装用電子部品に設けられた電極部が置かれるかたちで半田付けにより実装された表面実装領域とが設けられており、
さらに、前記特定制御部は、前記挿入実装領域と前記表面実装領域とのうち前記表面実装領域が形成されて該表面実装領域に前記複数の実装用電子部品のうちの種類のディスクリット部品のみが半田付けにより実装された特定基板を有しており、
前記一の種類のディスクリット部品は、前記挿入実装領域に設けられた隣接する特定の挿入孔のピッチ内に収まる大きさであるにもかかわらず、前記特定基板に形成された前記表面実装領域のうちパターン配線が形成されている部分に対して前記実装用電子部品としての電極部が半田付けされることにより実装された状態で前記特定基板共々にモールドされることにより、前記隣接する特定の挿入孔のピッチ内に収まらない大きさをもった一の実装用電子部品としての外観形状を有し、
さらに、前記特定基板は、当該特定基板から外側へと延びてこれとは別の基板上に設けられている前記挿入実装領域に挿入可能とされるように形成された特殊挿入実装用リード部を有しており、該特殊挿入実装用リード部が前記挿入実装領域に挿入されるかたちで半田付けにより実装されることで、前記別の基板上に設けられている前記挿入実装領域に半田付けにより実装された実装用電子部品との間で前記一の種類のディスクリット部品が電氣的に接続されるようになっており、

前記特殊挿入実装用リード部が前記挿入実装領域に挿入された状態での前記特定基板としての最も高い点の高さは、前記挿入実装領域に半田付けにより実装された実装用電子部品のうち最も高い実装用電子部品よりも低く、且つ前記挿入実装領域に半田付けにより実装された実装用電子部品のうち最も低い実装用電子部品よりも高いことを特徴とする遊技機

。

【手続補正２】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００５

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００５】

上記従来の遊技機では、遊技興趣が低下してしまうことが懸念される。

【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００７

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００７】

手段１：電極部を有しておりパッケージされた実装用電子部品を複数用いて遊技にかか
る制御が実行されうる特定制御部を備え、遊技に応じた演出表示にて特別の表示態様が現
れた場合、特典の付与が行われうる遊技機であって、前記複数の実装用電子部品には、デ
ィスクリート部品と集積回路部品とが含まれており、前記特定制御部には、パターン配線
が形成された基板内に実装用電子部品に設けられた電極部が挿入されるかたちで半田付け
により実装された挿入実装領域と、パターン配線が形成された基板の表面上に実装用電子
部品に設けられた電極部が置かれるかたちで半田付けにより実装された表面実装領域とが
設けられており、前記特定制御部には、パターン配線が形成された基板内に実装用電子部
品に設けられた電極部が挿入されるかたちで半田付けにより実装された挿入実装領域と、
パターン配線が形成された基板の表面上に実装用電子部品に設けられた電極部が置かれる
かたちで半田付けにより実装された表面実装領域とが設けられており、さらに、前記特定
制御部は、前記挿入実装領域と前記表面実装領域とのうち前記表面実装領域が形成されて
該表面実装領域に前記複数の実装用電子部品のうちの種類のディスクリート部品のみが
半田付けにより実装された特定基板を有しており、前記一の種類のディスクリート部品は
、前記挿入実装領域に設けられた隣接する特定の挿入孔のピッチ内に収まる大きさである
にもかかわらず、前記特定基板に形成された前記表面実装領域のうちパターン配線が形成
されている部分に対して前記実装用電子部品としての電極部が半田付けされることにより
実装された状態で前記特定基板共々にモールドされることにより、前記隣接する特定の挿
入孔のピッチ内に収まらない大きさをもった一の実装用電子部品としての外観形状を有し
、さらに、前記特定基板は、当該特定基板から外側へと延びてこれとは別の基板上に設け
られている前記挿入実装領域に挿入可能とされるように形成された特殊挿入実装用リード
部を有しており、該特殊挿入実装用リード部が前記挿入実装領域に挿入されるかたちで半
田付けにより実装されることで、前記別の基板上に設けられている前記挿入実装領域に半
田付けにより実装された実装用電子部品との間で前記一の種類のディスクリート部品が電
氣的に接続されるようになっており、前記特殊挿入実装用リード部が前記挿入実装領域に
挿入された状態での前記特定基板としての最も高い点の高さは、前記挿入実装領域に半田
付けにより実装された実装用電子部品のうち最も高い実装用電子部品よりも低く、且つ前
記挿入実装領域に半田付けにより実装された実装用電子部品のうち最も低い実装用電子部
品よりも高いことを特徴とする遊技機。

【手続補正４】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００８

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正 6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】削除

【補正の内容】